

Welco® LED120 T7 SAC305 號粉 免清洗型印刷焊錫膏

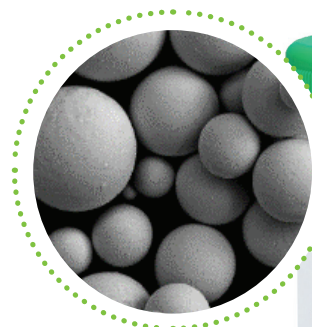
Welco® LED120 T7 SAC305 是一款採用領先技術的免清洗型印刷焊錫膏，主要針對MiniLED和MicroLED晶片焊接而設計。焊錫膏在最小70µm鋼板開孔的脫模性能極佳，且印刷性能穩定。LED120系列使用賀利氏專有的Welco®7號錫粉製造技術，可實現極高的焊接可靠性，且孔洞率低，充分滿足客戶的應用要求。

主要特性

- 使用高品質Welco® SAC305 T7錫粉
- 無鹵素，免清洗
- 孔洞率極低
- 大幅減少錫珠
- 在細間距印刷中焊錫膏脫模能穩定
- 在線使用壽命長(≥10小時)，印刷後至回流前可操作時間長(≥10小時)
- 在MiniLED應用中證明了其出色的可靠性和焊接強度

終端應用

- Mini和Micro LED 背光 (電視, 平板, 電視牆)
- 系統封裝(手機, 穿戴式智能設備)



高品質Welco 7號粉

- 焊粉尺寸分佈集中
- 焊粉形狀為真圓且均勻
- 批次間特性一致



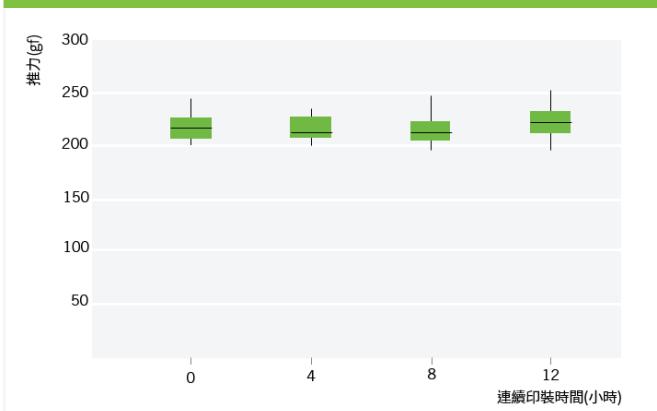
應用/製程



適用於MiniLED晶片焊接和SIP晶片倒裝焊接和無源器件的貼裝製程

連續印刷	0小時	4小時	8小時	12小時
低孔洞率(<10%), 008004 008004元件迴流焊後的x-ray 的狀況				
適合微小間距的印刷應用, 焊錫 膏可持續印刷在開口70微米, 間 距50微米的鋼板上				

元件推力



- 在元件008004持續達到高推力
- 焊盤材質是ENIG, 尺寸是130x140微米

產品特性

LED120 T7號粉焊錫膏

合金	Sn/Ag3/Cu0.5
熔點	217 - 219 °C
焊粉類型	Welco® Type 7
粒徑	2 - 11 µm
鹵素含量	無鹵素
助焊劑類型	免清洗型 / 溶劑清洗型
應用	印刷

美洲地區

電話 +1 610 825 6050
electronics.americas@heraeus.com

亞太

電話 +65 6571 7649
electronics.apac@heraeus.com

中國

電話 +86 53 5815 9601
electronics.china@heraeus.com

歐洲、中東和非洲

電話 +49 6181 35 4370
electronics.emea@heraeus.com

本文所述事實與技術數據均由賀利氏利用最新知識和現代實驗設備根據通用實驗流程測定得出。文中資訊均為出版前最新版本(可索要最新版本檔)。儘管數據均準確無誤,但賀利氏對上述數據是否得到合理引用或因引用上述數據導致的任何侵權後果均不承擔任何責任(除非事先以協定的形式獲得明確的書面同意)。消費者應根據本文所提供的數據針對特定應用對材料適用性進行測試。賀利氏標識、Heraeus、賀利氏和AgCoat為賀利氏集團或其附屬公司的商標或註冊商標。保留所有權利。